

INFORMATIONEN

Veranstaltungsort

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Heraeusstraße 12 – 14
63450 Hanau

Die Veranstaltung findet im Richard-Küch-Forum statt.

Parkmöglichkeiten im Parkhaus City-Center, Kurt-Blaum-Platz,
63450 Hanau.

Teilnehmergebühren/Anmeldung

Bitte benutzen Sie beiliegendes Anmeldeformular
(auch unter: www.dvs-ev.de/weichloeten2019).

Übernachtung

Folgendes Hotel kann besonders aufgrund der günstigen Lage
empfohlen werden:

Plazahotel Hanau, Kurt-Blaum-Platz 6, 63450 Hanau,
T 06181 30550, F 06181 3055444, hanau@plazahotels.de
Die Zimmer (EZ Standard EUR 87; EZ Komfort EUR 97) können
unter dem Stichwort „Weichlöttagung“ bis zum 26. August 2019
abgerufen werden

Referenten / Moderator

Eppinger, Harald	KOH YOUNG Europe GmbH, Alzenau
Grimmer-Herklotz, Udo	FELDER GmbH Löttechnik, Oberhausen
Heilmann, Norbert	ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG, München
Hofmann, Christian	Fraunhofer ENAS, Chemnitz
Niemeier, Jörg	ATN Automatisierungs- technik Niemeier GmbH, Berlin
Nowotnick, Mathias	Universität Rostock, Rostock
Hohlfeld, Dennis	Universität Rostock, Rostock
Schmidt, Joachim	Berlin
Schmidt, Roman	First Sensor AG, Berlin
Trodler, Jörg	Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau
Vogel, Klaus	Fraunhofer ENAS, Chemnitz

Programmkommission

Fix, Andreas	Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen
Grimmer-Herklotz, Udo	FELDER GmbH Löttechnik, Oberhausen
Hutter, Matthias	Fraunhofer IZM, Berlin
Nowotnick, Mathias (Vorsitz)	Universität Rostock, Rostock
Thüsing, Johannes	Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Balve
Trodler, Jörg	Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau
Weinreich, Michael M.	DVS e. V., Düsseldorf
Weinreich, Simone	DVS e. V., Düsseldorf
Wilke, Klaus	Siemens AG, Berlin

Veranstalter

**DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte
Verfahren e. V.**

Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf
T +49 211 1591-302/-303
F +49 211 1591-300

tagungen@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de/weichloeten2019

SPONSOREN

Gold:

Heraeus

Silber:

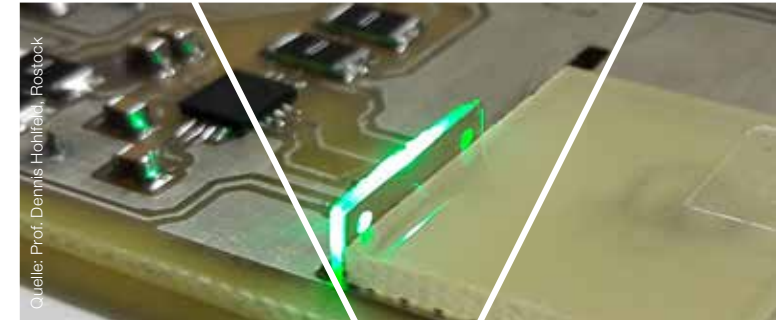
BALVER ZINN® 

Bronze:

FELDER
1862 1919
LÖTTECHNIK

**VLIESTOFF
KASPER**

PFARR
WIR BRINGEN LÖTE IN FORM
GETTING SOLDER INTO SHAPE



Quelle: Prof. Dennis Hohlfeld, Rostock

6. DVS-Tagung

Weichlöten 2019 – Präzise Montage von Sensoren und optoelektronischen Bauelementen

Forschung und Praxis für
die Elektronikfertigung

Richard-Küch-Forum, Hanau
8. Oktober 2019

PROGRAMM

www.dvs-ev.de/weichloeten2019



EINLADUNG

Weichlöten 2019 – Präzise Montage von Sensoren und optoelektronischen Bauelementen

Der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. wird zusammen mit der Fachgesellschaft Löten im DVS am 8. Oktober 2019 im Richard-Küch-Forum in Hanau die Tagung „Weichlöten 2019“ durchführen.

Elektronische Baugruppen entwickeln sich immer weiter zur multifunktionalen Baugruppe. Optische Komponenten, Sensoren und Aktoren erfordern Lötverbindungen, die nicht nur leitfähig, mechanisch stabil und zuverlässig sind, sondern auch eine präzise Ausrichtung gewährleisten. Während in der Standard-SMT das sogenannte „Self-Alignment“ Toleranzen beim Bestücken ausgleicht, kann für fokussierte LEDs oder Sensoren gerade dieser Effekt die präzise Justierung verhindern. Auch nach dem Lötprozess muss oftmals eine Genauigkeit von wenigen Mikrometern in x-, y- und z-Richtung gewährleistet werden.

Referenten aus Industrie und Forschung geben auf der Weichlöten 2019 einen kompetenten Einblick über spezielle Montage- und Lötverfahren mit hoher Präzision sowie Anwendungen mit besonderen Anforderungen an eine genaue Positionierung der Komponenten mit hoher Reinheit und geringem thermischen Stress.

Die Veranstalter bedanken sich bei der Programmkommission für die Zusammenstellung der Vorträge sowie bei den Referenten und Sponsoren für die Unterstützung bei der Durchführung der Tagung.

Wir sind sicher, Ihnen eine attraktive Veranstaltung bieten zu können, und freuen uns auf Ihr Kommen.

■ Mathias Nowotnick

Vorsitzender der Programmkommission

■ Michael M. Weinreich

Geschäftsführer Fachgesellschaft „Löten“ im DVS

PROGRAMM

8. Oktober 2019

10:00 Begrüßung / Moderation

Mathias Nowotnick

10:10 Die Kunst, eine Orgel zu bauen

Joachim Schmidt

10:45 Flussmittel- und Feststoffanteile in modernen Lötmitteln – Visionen und (Mindest-)Anforderungen

Udo Grimmer-Herklotz

11:15 Kaffeepause

11:30 Optimierung der SMT-Prozesse für die Reel-To-Reel-Fertigung

Jörg Niemeier

12:00 Wie genau müssen SMT-Bauteile bestückt werden?

Norbert Heilmann

12:30 Selbstzentrierung für zusammengesetzte Sensor-Arrays

Roman Schmidt

13:00 Mittagsimbiss

13:45 Integration von mikrooptischen Elementen in elektrische Leiterplatten für optofluidische Systeme und zur Datenübertragung

Dennis Hohlfeld*, Haldor Hartwig, Jendrik Schmidt, Ekaterina Sergeeva (*Vortragender)

14:15 Wie viel 3D-AOI benötigt eine zukunftsorientierte Fertigung?

Harald Eppinger

14:45 Kaffeepause

PROGRAMM

8. Oktober 2019

15:00 Induktionserwärmung für das Cu-Sn SLID Waferbonden zum Packaging in der Mikro-systemtechnik

Christian Hofmann

15:30 Reaktive Multilagensysteme als interne Wärmequelle zum Fügen auf Wafer-, Chip- und Komponentenebene

Klaus Vogel

16:00 Materialien und Materialkombinationen zur präzisen Positioniergenauigkeit

Jörg Trodler

16:30 Schlussworte

Mathias Nowotnick



Bild: 123rf